

## Handbuch der Leiterplattentechnik Band 4



- Basismaterialien
- Leiterbildstrukturierung
- Mechanisches Bohren
- Toleranzbetrachtungen zum Registrieren von HDI-Baugruppen
- Chemisch-physikalische Grundlagen
- Chemische Prozesse
- Endoberflächen und Zusatzdrucke
- Elektrischer Test
- Leiterplattentechnologien
- Herstellung räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger 3-D MID
- Hybridschaltungen
- Steckverbinder für Leiterplatten
- Standards - Normen und Richtlinien für die Leiterplattentechnik
- Tabellen-Anhang
-